

低コスト高電気伝導性金属メッシュ タッチパネル モジュール

説明

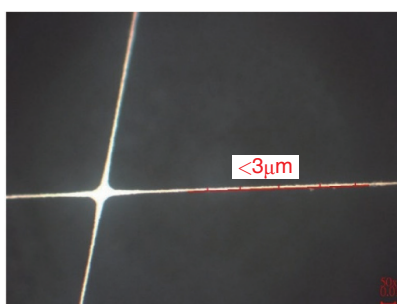
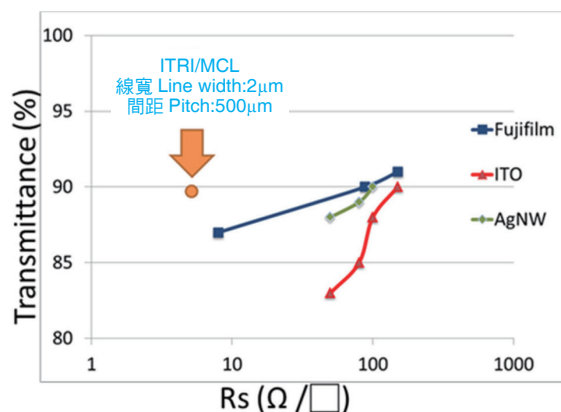
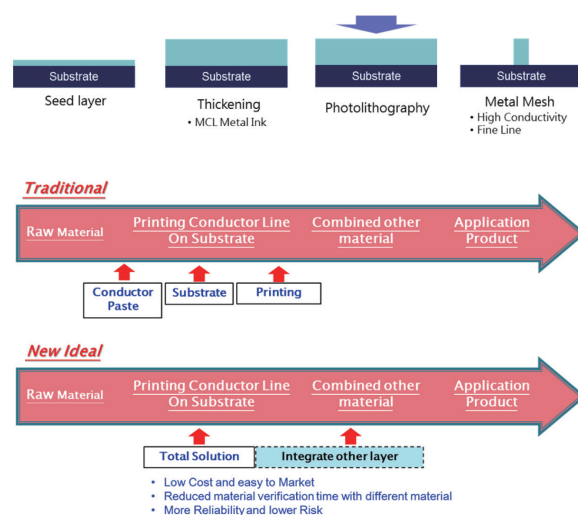
ITRI/MCL は、金属増厚技術と簡単湿式プロセスで金属メッシュの製造技術を開発しました。タッチ モジュールの開発も進めており、低コストの金属メッシュ プロセス製造技術を実現しました。また、内蔵型金属配線技術により、フレキシブルで極薄化フレキシブル タッチ モジュールを実現しました。

特徴

湿式プロセスの金属増厚技術で金属メッシュの配線の電気伝導率が上昇し、大面積の湿式塗布プロセスに適用できます。製造プロセスは簡単で、各種の構造のタッチ用透明導電性フィルムにも適用できます。内蔵金属配線技術に加えて、極薄化フレキシブル タッチ モジュールを実現しました。

仕様

- Fine Line width : 3 μ m
- Material : Silver
- Resistivity : 8 μ Ω cm
- TP : GG DITO, FF, G2(on-cell)



お問い合わせ

TEL : +886-3-5914142 • +886-3-5915178
E-Mail : materialsnet@itri.org.tw
<http://www.materialsnet.com.tw/eng/mcltech/index-j.html>

技術連絡先

盧俊安 Chun-An Lu
E-Mail : luchunan@itri.org.tw
TEL : +886-3-5914133

